【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成23年2月17日(2011.2.17)

【公開番号】特開2008-277766(P2008-277766A)
【公開日】平成20年11月13日(2008.11.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-045
【出願番号】特願2008-60886(P2008-60886)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｇ　4/30　(2006.01)
Ｈ０１Ｇ　4/12　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｇ　4/30　３０１Ｅ
Ｈ０１Ｇ　4/30　３０１Ｃ
Ｈ０１Ｇ　4/12　３５８
Ｈ０１Ｇ　4/12　３６１
Ｈ０１Ｇ　4/12　３６４

【手続補正書】
【提出日】平成22年12月24日(2010.12.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
セラミック粉体とブチラール樹脂とを含むセラミックグリーンシートと、所定パターンの内部電極パターン層と、を交互に複数重ねて、グリーンセラミック積層体を得る工程を有する積層セラミック電子部品の製造方法であって、
前記ブチラール樹脂の重合度が、１０００～２４００であり、
前記内部電極パターン層を形成するための内部電極ペーストが、導電体粉末と、有機バインダと、を有しており、
前記有機バインダは、エチルセルロースと、粘着付与剤としてのガムロジン、ロジングリセリンエステルおよび脂環族石油樹脂から選ばれる少なくとも１つと、を有しており、
前記有機バインダが、前記導電体粉末１００重量部に対して、２重量部超９重量部未満含有され、前記有機バインダの含有量に対する前記粘着付与剤の含有比率が、５～５０重量％であることを特徴とする積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項２】
前記ブチラール樹脂が、前記セラミック粉体１００重量部に対して、５重量部超１０重量部未満含有されている請求項１に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項３】
前記エチルセルロースの重量平均分子量が、１９００００以上２５００００未満である請求項１または２に記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項４】
前記エチルセルロースのエトキシル基含有率が、４６．１重量％超５２．０重量％未満である請求項１～３のいずれかに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。
【請求項５】
前記ブチラール樹脂のブチラール化度が、５５モル％超７７モル％未満である請求項１～４のいずれかに記載の積層セラミック電子部品の製造方法。

【請求項６】
セラミック粉体とブチラール樹脂とを含むセラミックグリーンシートと、所定パターンの内部電極パターン層と、を交互に複数重ねて、グリーンセラミック積層体を得る工程を有する積層セラミック電子部品の製造方法であって、
前記ブチラール樹脂の重合度が、１０００～２４００であり、
前記ブチラール樹脂のブチラール化度が、５５モル％超６３モル％以下であり、
前記内部電極パターン層を形成するための内部電極ペーストが、導電体粉末と、有機バインダと、を有しており、
前記有機バインダは、エチルセルロースと、粘着付与剤としてのテルペンフェノールと、を有しており、
前記有機バインダが、前記導電体粉末１００重量部に対して、２重量部超９重量部未満含有され、前記有機バインダの含有量に対する前記粘着付与剤の含有比率が、５～５０重量％であることを特徴とする積層セラミック電子部品の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
また、本発明に係る積層セラミック電子部品の製造方法は、
セラミック粉体とブチラール樹脂とを含むセラミックグリーンシートと、所定パターンの内部電極パターン層と、を交互に複数重ねて、グリーンセラミック積層体を得る工程を有する積層セラミック電子部品の製造方法であって、
前記ブチラール樹脂の重合度が、１０００～２４００であり、
前記ブチラール樹脂のブチラール化度が、５５モル％超６３モル％以下であり、
前記内部電極パターン層を形成するための内部電極ペーストが、導電体粉末と、有機バインダと、を有しており、
前記有機バインダは、エチルセルロースと、粘着付与剤としてのテルペンフェノールと、を有しており、
前記有機バインダが、前記導電体粉末１００重量部に対して、２重量部超９重量部未満含有され、前記有機バインダの含有量に対する前記粘着付与剤の含有比率が、５～５０重量％であることを特徴とする。